

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2025 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]195 号文《关于同意上海新阳半导体材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98 万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97 万元。本次募集项目资金于 2021 年 4 月存入公司募集资金专用账户中，并已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2021）第 03522 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

公司于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98 万元，根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2021）第 03522 号《验资报告》，本次向特定对象发行股票扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97 万元。天风证券股份有限公司从募集资金总额中提取的承销保荐费用（含税）为 396.00 万元。天风证券股份有限公司将扣除承销保荐费用（含税）后的资金打款到本次募集资金专户中，金额为 78,803.98 万元，其中含未能及时置换发行费用 50.01 万元，扣除后实际募集资金净额为 78,753.97 万元。

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项议案》，同意变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”部分募集资金用途，用于新增项目“ArF 浸没式光刻胶研发项目”及“偿还项目贷款”，同时对募集资金投资项目“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”预计完成时间进行调整，并将“集成电路关键工艺材料项目”结项。本报告期，公司将“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”的原投资金额 42,553.97 万元，调减至 18,239.97 万元。其中，调减的 24,314.00 万元用于新增的“ArF 浸没式光刻胶研发项目”16,500 万元以及“偿还项目贷款”项目 7,814.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	本次募集 资金金额	期初募集 资金余额	本期实际 使用金额	募集资金 期末余额
集成电路制造用高端光刻胶 研发、产业化项目	18,239.97	4,159.57	4,159.57	-
集成电路关键工艺材料项目	21,200.00	-	-	-
补充流动资金	15,000.00	-	-	-
ArF 浸没式光刻胶研发项目	16,500.00	12,129.44	5,425.29	6,704.15
偿还项目贷款	7,814.00	-	-	-
合计	78,753.97	16,289.01	9,584.86	6,704.15

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议。

（二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况

本公司为本次向特定对象发行股票募集资金开设了四个专项账户，分别为开户行：上海银行股份有限公司松江支行（以下简称“上海银行松江支行”）账号为 03004477827；开户行：中国建设银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“建行松江支行”）账号为：31050180360000003196；开户行：宁波银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“宁波银行松江支行”）账号为：70040122000491141；开户行：浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海分行”）账号为：2900000010120100728563。本公司已连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与上海银行松江支行、建行松江支行、宁波银行松江支行和浙商银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》并发表：2021-024 公告。

公司于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项议案》，同意变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”部分募集资金用途，用于新增项目“ArF 浸没式光刻胶研发项目”及“偿还项目贷款”，同时对募集资金投资项目“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”预计完成时间进行调整，并将“集成电路关键工艺材料项目”结项。

基于上述决议，公司将原用于“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”的募集资金专户宁波银行松江支行（账号为：70040122000491141）变更用于“ArF 浸没式光刻胶研发项目”募集资金的存储与使用，并于 2024 年 6 月与宁波银行松江支行及保荐机构天风证券重新签订了《募集资金三方监管协议》并发表：2024-040 公告。

2024 年 6 月 27 日，上海银行松江支行和建行松江支行两个募集资金专项账户的资金按计划使用完毕，公司已办理了注销专项账户手续，详见 2024-039 公告。专户注销后，公司、保荐机构与上述专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截止 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	开户银行	账号	期末余额
1	集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	浙商银行上海分行	2900000010120100728563	3,315,965.10
2	ArF 浸没式光刻胶研发项目	宁波银行松江支行	70040122000491141	30,223,389.58
	合计			33,539,354.68

截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次募集资金合计 67,041,501.85 元，未能及时置换发行费用合计 500,125.04 元，累计产生利息收入 45,954,382.90 元。截止 2024 年年末，6,232,910.09 元利息收入已使用于集成电路关键工艺材料项目；因项目结项或变更，公司对募集资金账户进行了销户，所以将募集资金产生的利息净收入 19,148.18 元转入基本户。2025 年内集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目募集资金已全部使用完毕，后续公司又使用了该项目募集资金产生的利息 33,704,596.84 元继续投入。截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金及利息进行理财合计 40,000,000.00 元（相关公告编号：2025-049）。募集资金账户余额合计 33,539,354.68 元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司募集资金的使用情况详见附表-1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式改变情况

本报告期，本公司不存在改变募集资金投资项目实施地点或实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司本次向特定对象发行股票无以募集资金置换自有资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金及利息进行理财合计 40,000,000.00 元（相关公告编号：2025-049）。募集资金账户余额合计 33,539,354.68 元。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期，本公司不存在节余募集资金。

（七）超募资金使用情况

本公司向特定对象发行股票无超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次募集资金合计 67,041,501.85 元，未能及时置换发行费用合计 500,125.04 元，累计产生利息收入 45,954,382.90 元。截止 2024 年年末，6,232,910.09 元利息收入已使用于集成电路关键工艺材料项目；因项目结项或变更，公司对募集资金账户进行了销户，所以将募集资金产生的利息净收入 19,148.18 元转入了基本户。2025 年内集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目募集资金已全部使用完毕，后续公司又使用了该项目募集资金产生的利息 33,704,596.84 元继续投入。

（九）募集资金使用的其他情况

本报告期，募集资金使用无其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵守深圳证券交易所《上市公司募集资金监管规则》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：改变募集资金投资项目情况表

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日

附表 1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额			78,753.97				本报告期投入募集资金总额			9,584.86	
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额			72,049.82	
累计改变用途的募集资金总额			24,314.00								
累计改变用途的募集资金总额比例			30.87%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截至报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	是	42,553.97	18,239.97	4,159.57	18,239.97	100.00%	2027-4-21	-6,360.01	-28,219.15	否	否
ArF 浸没式光刻胶研发项目	否		16,500.00	5,425.29	9,795.85	59.37%	2027-4-21	-	-	不适用	否
偿还项目贷款	否		7,814.00	-	7,814.00	100.00%		-	-	不适用	否
集成电路关键工艺材料项目	否	21,200.00	21,200.00	-	21,200.00	100.00%	2024-3-13	-3,940.99	-5,133.32	否	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%		-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		78,753.97	78,753.97	9,584.86	72,049.82			-10,301.00	-33,352.47		
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		78,753.97	78,753.97	9,584.86	72,049.82			-10,301.00	-33,352.47		

附表 1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）（续）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目中“KrF 厚膜光刻胶”项目已经达到预定可使用状态，产品已经通过客户认证，取得订单并产生销售收入，“ArF 干法光刻胶”项目的产线已投入运行，研发仍在进行，未能完全达到预计效益。</p> <p>2、“集成电路关键工艺材料项目”：合肥工厂规划产能已完成建设，产线已能够投入使用，但部分产品尚需客户验证，因此收入规模及盈利情况不及预期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点改变情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况	截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金及利息进行理财合计 40,000,000.00 元（相关公告编号：2025-049）。募集资金账户余额合计 33,539,354.68 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的本次募集资金合计 67,041,501.85 元，未能及时置换发行费用合计 500,125.04 元，累计产生利息收入 45,954,382.90 元。截止 2024 年年末，6,232,910.09 元利息收入已使用于集成电路关键工艺材料项目；因项目结项或变更，公司对募集资金账户进行了销户，所以将募集资金产生的利息净收入 19,148.18 元转入了基本户。2025 年内集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目募集资金已全部使用完毕，后续公司又使用了该项目募集资金产生的利息 33,704,596.84 元继续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目相关效益计算包含自有资金投入。本报告中披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目与前次募集资金中 193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目系同系列最终产品，所以该项目的收益指标与 193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目统一计算。

附表 2：改变募集资金投资项目情况表（单位：万元）

改变后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	18,239.97	4,159.57	18,239.97	100.00%	2027-4-21	-6,360.01	否	否
ArF 浸没式光刻胶研发项目	集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	16,500.00	5,425.29	9,795.85	59.37%	2027-4-21	-	不适用	否
偿还项目贷款	集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目	7,814.00		7,814.00	100.00%	不适用		不适用	否
合计	--	42,553.97	9,584.86	35,849.82	--	--	-6,360.01	--	--
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项议案》，同意变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”部分募集资金用途，用于新增项目“ArF 浸没式光刻胶研发项目”及“偿还项目贷款”，详见公司于 2024 年 3 月 15 日发布的 2024-010 公告。</p> <p>“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”：由于现有产品、产线已满足募投项目规划需求，为提升募集资金使用效率，公司决定调减“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”拟投入募集资金金额，优先投入其他项目。</p> <p>“ArF 浸没式光刻胶研发项目”：ArF 浸没式光刻胶研发项目是国家掌握产业自主权的重大战略性需求。对公司而言，实施本项目是占领技术和市场高地、进一步巩固行业地位、拓展新业绩增长点的重要发展方向，具有重大战略意义。</p> <p>“偿还项目贷款”：ArF 浸没式光刻胶项目立项初期，为避免光刻机进口管制等不利因素的影响，公司先行购置了 ArF 浸没式光刻胶项目用光刻机设备，保障 ArF 浸没式光刻胶项目研发进度，公司采用了项目贷款形式支付设备款。募集资金到账后，存在部分闲置资金，提前偿还项目设备贷款，有利于降低公司财务成本，更好地满足公司战略发展的资金需求。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目中“KRF 厚膜光刻胶”项目已经达到预定可使用状态，产品已经通过客户认证，取得订单并产生销售收入，“ARF 干法光刻胶”项目的产线已投入运行，研发仍在进行，未能完全达到预计效益。</p>								
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>不适用。</p>								